

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2023-055

上海灿瑞科技股份有限公司
关于全资子公司签订土地使用权出让合同
暨募投项目实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

一、芯片研发中心项目概述

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的议案》及《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，变更了部分首发募投项目实施地点和超募资金投向，将公司首次公开发行的募投项目“高性能传感器研发及产业化项目”、“电源管理芯片研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”实施地点变更为上海市普陀区桃浦智创城 104-02 地块（以下简称“新地块”），将原“研发中心建设项目”剩余未投入部分募集资金变更为“芯片研发中心项目”后在新地块继续实施，并将原首发募投项目“高性能传感器研发及产业化项目”及“电源管理芯片研发及产业化项目”中部分与房产设备投入相关的部分变更至“芯片研发中心项目”后在新地块实施；由于新的研发中心包含首次公开发行超募部分且投资总额较原先有大幅变化，研发中心项目建设名称变更为“芯片研发中心项目”。此次变更后“芯片研发中心项目”投资总额 114,501.65 万元，主要用于土地购置、建筑工程及装修、研发费用和软硬件设备购买等。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司上海灿瑞微电子有限公司（以下简称“灿瑞微电子”）作为“芯片研发中心项目”的实施主体。

二、芯片研发中心项目进展情况

灿瑞微电子按照法定程序参与了上海市普陀区规划和自然资源局发布的普陀区桃浦科技智慧城（W06-1401 单元）104-02 地块国有土地使用权挂牌出让竞拍，以人民币 282,000,000.00 元竞得，并于近期签署了《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：202301208000772。

三、合同主要条款

1、合同双方：

出让方：上海市普陀区规划和自然资源局

受让方：上海灿瑞微电子有限公司

2、宗地编号：202307579099488932

3、宗地坐落：上海市普陀区桃浦镇，四至范围东至：绿蕉路，南至：乐创路，西至：皋兰山路，北至：武山路。

4、土地用途：科研设计用地。

5、土地面积：12110.30 平方米

6、出让年限：50 年

7、转让价款支付：自合同签订之日起的 5 个工作日内支付土地出让价款的 20%作为定金，定金抵作土地出让价款；土地出让价款余额于合同签订之日起 30 个工作日内一次性付清。

四、本次取得土地使用权对公司的影响

本次取得的土地未来将用于“芯片研发中心项目”建设，有利于公司吸引行业内高素质的研发人才，进一步加强公司研发团队建设，有利于增强公司研发能力，提升公司市场竞争地位。本次竞拍土地与募集资金规划用途保持一致，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日